



SiC, GaN 加工技術展 2025

出展申込書

2025年3月5日(水)～7日(金)
10:00～17:00 幕張メッセ 7-8ホール

問い合わせ・送付先:産経新聞社 事業本部 コンベンション事業部 [Grinding Technology Japan 2025/SiC,GaN加工技術展 2025]事務局
〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL. 03-3273-6180 E-mail. Grinding Technology Japan 2025 gtj@sankei.co.jp
FAX. 03-3241-4999 SiC,GaN加工技術展 2025 sicgan@sankei.co.jp

※必ずコピーをとり、控えとしてください。

出展規約を了承し、下記のとおり出展申し込みいたします。

年 月 日

(本展の招待状やホームページ等に掲載される名称となります。※略称でも結構です。)

会社名(和文) ぶりがな 国名()

印

(英文)

※共同出展のある場合、下記にご記入ください。ただし、連絡先は原則として1社となります。また、共同出展の所在が国外の場合、国名をご記入ください。
Company Limitedの場合は、統一のためCo., LtdあるいはCO., LTDとして掲載いたします。
ご希望がございましたら、メモとしてご記入ください。

共同出展社名(和文) ぶりがな (英文) 国名()

共同出展社名(和文) ぶりがな (英文) 国名()

出展者みどころ情報 50文字以内(ホームページに掲載いたします。)

2024年の1月(予定)から「会社名」及び「見どころ情報」を順次に50音順で公式HPに掲載いたします。掲載が難しい場合のみ、 掲載しない
チェックしてください。

インターネットホームページアドレス (和文) http://
(英文) http://

◆和文招待状を[]枚 ◆英文招待状(予定)を[]枚 希望する(無料で何枚でもお送りします。)

会社/団体名(連絡・請求先の社名・団体名となります。)

代表者氏名 代表者役職

展示担当者所在地 〒
ハイフン不要

Tel. Fax.

担当者名(ぶりがな) 担当者所属部課名・役職名

担当者e-mail(出展者様のIDとなりますので、必ずご記入ください。)

請求担当連絡先(展示担当者と異なる場合のみご記入ください。)

〒
ハイフン不要

請求担当名(ぶりがな) 請求担当者所属部課名・役職名

Tel.

Fax.

出展展示会(チェックを入れてください)
 Grinding Technology Japan 2025 SiC,GaN加工技術展 2025

申込内容		料金単価(税込)	料 金(税込)	
Aタイプ (一般)	()小間	1～9小間 418,000円	①	小間レイアウト (4小間以上出展社のみご記入ください) ※3小間までのご出展は、並列小間でご用意します。 <input type="checkbox"/> 並列 <input type="checkbox"/> ブロック(ダブル) <input type="checkbox"/> 独立ダブル <input type="checkbox"/> 独立トリプル <input type="checkbox"/> 対向 <input type="checkbox"/> 特別アレンジ() ※会員価格はGrinding Technology Japan 2025に出展をご希望の特別協賛の法人会員のみ選択できます
		10～19小間(5%割引) 397,100円		
		20小間～(10%割引) 376,200円		
Aタイプ (会員)	()小間	352,000円		
Bタイプ (一般)	<input type="checkbox"/> 申込む	242,000円	②	1小間限定
Bタイプ (会員)	<input type="checkbox"/> 申込む	220,000円		1小間限定 ※会員価格はGrinding Technology Japan 2025に出展をご希望の特別協賛の法人会員のみ選択できます
製品・技術説明会				
()セッション		55,000円	③	開催中、45分間
<テーマ>(40字まで)				
<input type="text"/>				
ホームページ広告				
()枠		55,000円	④	W200px × H40px、GIF形式 ※アニメーションGIF可
※原稿締切日までにリンク先指定の上、完成データをご提出下さい。				

合計料金(税込) 円 ①～④までの合計

「個人情報の取り扱いについて」 ご登録いただきました個人情報は、本展の運営管理、実施、主催者の事業活動等のご案内のために利用させていただく場合があります。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、主催者および業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督いたします。

出展予定にチェックしてください。(複数可)

Grinding Technology Japan 2025

研削盤 研磨盤 砥石 ツルレーシング装置 計測機器 周辺機器 工具研削盤 切削工具 研削加工技術
 切削工具加工技術 切削工具活用技術 切削油 切削油供給装置 切削油ろ過装置 工具素材もしくは工具材料
 その他: _____

SiC,GaN加工技術展 2025

SiC,GaN用インゴットスライシング装置 SiC,GaN用ウエハ研削装置 SiC,GaN用研削砥石 ウエハ端面研削・研磨装置
 SiC,GaN用片面・両面ラッピング装置 SiC,GaN用CMP装置 SiC,GaNウエハ専用研磨材スラリー
 ウエハ洗浄システム ウエハ形状測定機 その他: _____

